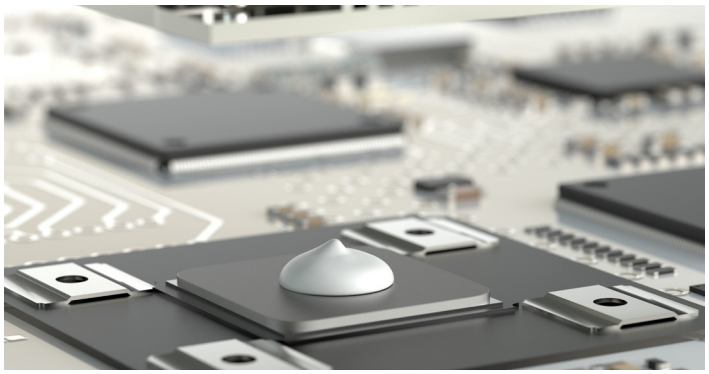
LOCTITE®

BERGQUIST®

# 5G移动手机的高效“散热神器”

## LOCTITE® BERGQUIST® LIQUI FORM TLF 6000HF

LOCTITE® BERGQUIST® LIQUI FORM TLF 6000HF 是一种单组分预固化的凝胶热界面材料 (TIM)，专为满足大规模生产和5G移动设备高功率散热的需求而设计。



基于有机硅的热界面材料 (TIM) 具有6.0 W/m-K的高热导率，可高效传递IC的工作热量，减少可能对芯片功能产生的不利影响。此外，用作芯片和EMI屏蔽罩之间的热界面材料 (TIM)，LOCTITE® BERGQUIST® LIQUI FORM TLF 6000HF 的良好电气性能（高体积电阻率和表面电阻率）确保了IC的正常运行。LOCTITE® BERGQUIST® LIQUI FORM TLF 6000HF 的低应力和高性能为消费电子领域带来了创新的散热解决方案。

Henkel

Henkel Adhesive Technologies

LOCTITE

BERGQUIST

## 主要特性

- >6.0 W/m-K的高导热性（经测试为6.72 W/m-K）
- 13.7克/分钟的快速流速（平均值，1.2毫米点胶针）
- 良好、稳定的点胶性能
- 良好的电气性能，体积电阻高达3E12 Ω.cm，表面电阻高达2E12 Ω.cm
- 间隙稳定性高，无垂流
- 装配应力低

## 主要优势

- 高效率大批量生产
- 增强5G设备可靠性
- 减少应用过程中对高价值芯片的压力
- 兼容各类点胶设备
- 储存和加工工艺简单，无需混合

## 关键应用

- 5G移动设备
- 电信
- 电脑处理器
- 消费类电子产品

## 未固化时典型特性

| | |
|---|---|
| **粘度，TA DHR3, PP25 cone @ 25°C, mPa·s (cP):** | |
| 1毫米间隙 @ 剪切率1 $s^{-1}$ | 696,000 |
| 密度，ASTM D792, g/cc | 3.4 |
| **流动率 @ 90 psi, g/min:** | |
| 30cc EFD | 108.7 |
| 30cc EFD带1.2毫米针头 | 13.7 |

## 固化后典型特性

| | |
|---|---|
| **物理特性** | |
| 硅氧烷含量，ΣD3-D10, ppm | 80 |
| **热性能** | |
| 热导率，ASTM D5470, W/(m-K) | 6.72 |
| **电气性能** | |
| 体积电阻率，ASTM D257，欧姆–厘米 | $3 \times 10^{12}$ |
| 表面电阻率，ASTM D257，欧姆 | $2 \times 10^{12}$ |

此处提供的信息，包括产品用途、性能以及对产品使用和应用的建议，均基于获得相关数据之时所掌握的与产品相关的知识及经验而来，会因实际操作条件的变化而不同。强烈建议在使用产品前进行测试以确定该产品的适用性。对于上述信息或任何口头建议，我们不承担任何责任，除非我们对重大过失或故意承担责任。以上所有信息受版权保护。尤其是任何在其他媒体上的复制、改编、翻译、存储和处理，包括以电子方式存储或处理，均享有版权保护。对其全部或部分的任何利用均需事先获得 Henkel AG & Co. KGaA 的书面同意。

® 除另有说明，本文档中使用的所有商标均为汉高和 / 或其在美国、德国和其他地方的附属公司的商标和 / 或注册商标。

© 2022年汉高股份有限及两合公司。保留所有权利。(12/2022)

**想要一个可靠、稳定的散热解决方案来冷却移动IC并提高性能？**
与汉高TIM技术专家取得联系。

**汉高总部**

**Henkel AG & Co. KGaA**
Henkelstraße 67
40589 Düsseldorf
Germany

电话：+49.211.797.0

**亚太及大中华区总部**

**汉高（中国）投资有限公司**
中国上海市杨浦区江湾城路99号
尚浦中心7号楼 200438

电话：+86.21.2891.8000

**北美**

**Henkel Corporation**
14000 Jamboree Rd
Irvine, CA 92606
United States

电话：+1.855.243.6535

**HENKEL.COM/ELECTRONICS**

Henkel